

Michael Pecht



Pays : **États-Unis**

Langue : **Anglais**

Sexe : **Masculin**

Note : **Ingénieur électricien et mécanicien. - Directeur, Computer aided life cycle engineering, CALCE, Center for electronic packaging, University of Maryland, College park (en 1999). - Professeur, Mechanical Engineering department, University of Maryland, College park (en 1988). - Éditeur, "IEEE Transactions on reliability" (en 1991)**

Autre forme du nom : **Michael G. Pecht**

ISNI : **ISNI 0000 0001 1610 8962 (Informations sur l'ISNI)**

Michael Pecht : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr)

Œuvres textuelles (7)



Encapsulation technologies for electronic applications ⓘ
(2018)

Encapsulation technologies for electronic applications ⓘ
(2009)

China's electronics industry, the definitive guide for companies and policy makers with interests in China ⓘ
(2007)

Voir plus de documents de ce genre






Œuvres mixtes (6)

Guidebook for managing silicon chip reliability (1999)		Soldering processes and equipment (1993)	
--	---	--	---

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Michael Pecht (15 ressources dans data.bnf.fr)











Technique (7)






Appareils électroniques		Fiabilité	
Ingénierie		Mise sous boîtier (électronique)	
Montage en surface (électronique)		Plomb -- Réduction	
Télécommunications			

Informatique (3)

Apprentissage automatique		Internet des objets	
Systèmes d'exploitation (ordinateurs)			

Savoir et érudition. Musées (1)





Appareils électroniques		Apprentissage automatique	
Encapsulation (électronique)		Fiabilité	
Ingénierie		Internet des objets	
Matières plastiques dans l'emballage		Microencapsulation	
Mise sous boîtier (électronique)		Montage en surface (électronique)	

Plomb – Réduction		Produit d'apport (brasage)	
Silicium		Systèmes d'exploitation (ordinateurs)	
Télécommunications			

Chimie (1)




Silicium	
----------	---

Autres (3)

Encapsulation (électronique)		Matières plastiques dans l'emballage	
Microencapsulation		Produit d'apport (brasage)	

Personnes ou collectivités en relation avec "Michael Pecht" (9 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (5)

Sanka Ganesan		Edward B. Hakim	
Myeongsu Kang		Pradeep Lall	
Luu T. Nguyen			

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4)

Haleh Ardebili		Riko Radojcic	
Gopal K. Rao		Jiawei Zhang	

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr)

À la BnF (1)

.....
Notice correspondante dans Catalogue général

Sur le Web (7)

.....
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de la Bibliothèque nationale allemande

.....
Notice correspondante dans IdRef

.....
Notice correspondante dans ISNI

.....
Notice correspondante dans Library of Congress Authorities

.....
Notice correspondante dans Orcid

.....
Notice correspondante dans VIAF

.....
Notice correspondante dans Wikidata